グリーンシート積層体切断機
G-CUT UW12

パッケージやモジュール基板、燃料電池材料などへの高品質な加工ニーズに対応した切断機

2枚刃で長方形ワークへの加工も対応

環境に優しいクリーンな乾式カッティング

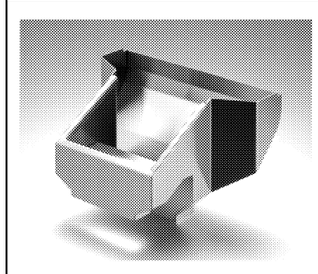
R&Dから量産（自動化）まで対応

ネプコン・ジャパン 2014
会期：2014/1/15~17
10:00～18:00
（17日のみ17:00終了）
会場：東京ビッグサイト 東16-9
ご来場お待ち申し上げております。

出展機
グリーンシート積層体切断機
G-CUT UW12

UHT株式会社
営業部
〒470-0162
愛知県愛知郡東郷町大字春木字下鏡田446-268
TEL：0561-38-2101 FAX：0561-38-2108
http://www.uht.co.jp/

精密板金



■タレットパンチプレス
■レーザー
■プレス
■ベンダー
■YAG、TIG、CO_2 溶接
■組立・塗装

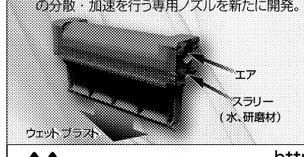
精密板金のことなら当社にお任せ！！

The Next Precision Sheet Metal
三条精密工業株式会社
〒955-0814　新潟県三条市乙497-14
TEL(0256)-32-1740　FAX(0256)-33-3148
bankinkakou@sanjyo-seimitsu.co.jp
http://www.sanjyo-seimitsu.co.jp/

特許出願中！
省スペースで低コストの
エコなブラスト誕生！
画期的な湿式物理表面処理装置「ブロワーウェットブラスト」

特徴
1）粒子加速にはブロワーエアを使用
大型ポンプやコンプレッサーが必要ありません。
2）小型でラインへの組み込みが容易
大型の付帯設備が必要なく、装置もコンパクトに。
3）エネルギー消費を抑えた低コスト
付帯設備の導入コストやランニングコストが不要。

■新開発のノズル形状 ※特許出願中
ブロワーの出力に合わせた理想的なスラリーの分散・加速を行う専用ノズルを新たに開発。



■アプリケーション例
・ドライフィルムラミネート前処理
・ソルダーレジスト前処理
・液状レジスト前処理
・レジスト現像後の残渣除去　など

マコー株式会社
http://www.macoho.co.jp
〒940-2032 新潟県長岡市石動町字金輪525
TEL:0258-47-1729　FAX:0258-21-4124

信頼の技術ブランド
神戸発優れた技術

実装技術の難題に挑戦する
玄人志向の坪田測器

私たち、「実装職人」が
1枚から実装を承ります。

多品種微量生産
高密度部品の実装
極小部品の実装
多層基板の実装

株式会社 坪田測器
TSUBOTA-SOKKI
お問い合わせはこちらまで
http://www.tsubota-sokki.com
TEL：078-975-4400
FAX：078-975-4405
坪田測器　検索

さらなる速さへ
ブースNo. 東11-002
スクリーン印刷機、各種自動化（FA）対応

Precision Screen Printers & Equipment Manufacturer
Micro-tec
マイクロ・テック株式会社
〒297-0012
千葉県浦安市入船1-5-2 NBF新浦安タワー13F
TEL：047-350-5131
FAX：047-350-5133
http://www.e-microtec.co.jp

MGP DISPENSERS
吐出精度の高い
2液混合ディスペンサー
2液混合吐出装置 ID-200N/ID-300N
ISO9001:2008 認証取得
接着剤等をお送りいただければ吐出テスト等を無償でお手伝いさせていただいています。

招待状差し上げます。
株式会社 日本省力技術研究所
インターネプコンジャパン出展
2014年1月15日（水）～17日（金）
東京ビッグサイト　東2ホール 東12-14
http://www.dispenser.jp
〒274-0825 千葉県船橋市前原西1-36-10 TEL.047(477)3521 FAX.047(477)3548
E-mail:inquiry2@dispenser.jp

プリント配線板EXPO

最先端の技術動向提供

「第15回プリント配線板EXPO PWB EXPO」は、あらゆるプリント配線板（PWB）から配線板用材料、電子基板設計ツール、設計・開発受託サービスまでが一堂に集まる展示会。エレクトロニクスメーカーの設計、研究開発部門にとって、最先端の技術動向を知る専門展として業界に定着している。会場は東展示棟5ホール。

PWBの業界動向ではスマートフォンやタブレット端末（携帯型情報端末）などモバイル機器向け需要の拡大が続いているため、大手PWBメーカーは製品開発、設備投資を活発化させている。モバイル機器向けでは高密度・薄型の基板が求められており、収益性が高いことなどから多くの企業が注力分野の一つに挙げている。

同展の主な出展内容は①プリント配線板―リジッドプリント配線板、3次元配線や屈曲部の配線に優れているフレキシブルプリント配線板（FPC）、多層プリント配線板、ビルドアッププリント配線板、部品内蔵配線板など②配線板用材料―リジッド銅張り積層板、フレキシブル銅張り積層板、シールド板、絶縁材料など―で構成。

特設ゾーンとして機能設計・理論設計支援ツールから解析・シミュレーションツール、CAD／CAMなどの「設計・開発ツールゾーン」と、エレクトロニクスの設計・開発・試作などにおける受託サービスが集結する「設計・開発受託ゾーン」が設けられる。昨今、エレクトロニクスメーカーは設計委託など事業の切り分けを進めており、来場者との活発な技術相談や委託相談などがみられそうだ。

併催企画の専門技術セミナーは、毎回業界関係者や来場者から注目を集めている。基調講演は荒川賢一NTTドコモ先進技術研究所長による「インテリジェントグラスがもたらす新たな未来」と題する講演など二つが行われる。日時は15日13時半から。

技術セミナーは「FPC業界の最新市場・技術動向」「熱対策のキー技術！広がりを見せる高熱伝導樹脂材料の開発最前線」「実用化が見えてきたプリンテッドエレクトロニクスの最先端技術動向」―など10セッション、計30セミナーが開かれる。最先端のプリント配線板技術動向を探る絶好の機会といえそうだ。

先端電子材料EXPO

小型・高機能化に対応

「第5回先端電子材料EXPO―マテリアルジャパン」は、小型・高機能化が進むエレクトロニクス製品の開発に必要な最新の電子材料や材料関連技術が一堂に集結する専門技術展。エレクトロニクス分野は急速な技術進歩で電子材料の果たす役割がますます大きくなっている。展示会場では高機能化、熱・ノイズ対策など課題解決に向けた技術相談や、サンプル依頼、材料合成委託などの技術相談や商談が活発に展開されそうだ。会場は東展示棟4ホール。

同展の主な出展製品は次の通り。

展示の中心となる電子材料は①実装回路材料―ポリイミドフィルム、液晶ポリマーフィルム、導電性ポリマー、導電性インク／ペースト、導電性接着剤など②プリンテッドエレクトロニクス材料―金属ナノ粒子／ペースト、導電性材料、誘電性材料など③記録媒体材料―ベースフィルム、樹脂など④半導体材料―封止材、フォトレジストなど⑤ディスプレー材料⑥電池材料⑦その他―機能性樹脂、ナノテクノロジー関連材料―などで構成。この他、「成型・加工装置、技術」「分析・試験・測定装置」「受託合成技術・サービス」に関連した数多くの機器・装置・サービスが展示される。特設ゾーンは今回新設される「接着剤・粘着剤ゾーン」に、「受託合成ゾーン」の二つが設けられる。

精密微細加工技術EXPO

高度な技術が一堂に

「第4回精密微細加工技術EXPO―マイクロテック ジャパン」が開催される。エレクトロニクス製品の開発・製造を支える板金、切削、プレス、電鋳、エッチング、表面処理、難素材加工技術など精密・微細加工技術を持った企業が一堂に集結する。来場対象者は電気・電子メーカー、電子デバイスメーカー、自動車・電装品メーカー、医療機器メーカー、発光ダイオード（LED）メーカーなど。会場は東展示棟3ホール。

同展の主な出展内容はプレス加工、切削加工、穴あけ加工、精密・微細板金技術、精密鋳造技術、金型・電鋳技術、微細接合技術、コーティング技術、エッチング技術、研磨・鏡面加工、バリ取り技術、表面処理／メッキ、レーザー加工、難削材加工、熱処理、受託試作などの技術が展示・実演される。会場では来場者との技術相談や商談が期待される。

展示会全体の概要、専門技術セミナーの詳細は同展の総合サイト（www.nepconjapan.jp/）へ。

近年、エレクトロニクス開発・製造において精密・微細加工技術が重要性を増している。こうした状況を背景に、エレクトロニクス業界向けの

ネプコン ジャパン2014

有力企業の製品・技術

〈順不同〉

さいたま市

「東日本のハブシティ」さいたま市。同市の誇る充実した交通網は首都圏と東日本をつなぐ「ハブ」として優れたビジネス環境を企業活動に提供する。災害リスク軽減の観点から内陸都市であることも活動の中核拠点として大いに魅力的である。

さいたま市は多様なビジネス支援を展開しているが、なかでも「さいたま市テクニカルブランド企業認証事業」は特徴的である。技術の独創性・革新性に優れた研究開発型企業を「テクニカルブランド企業」として認証する同事業では、認証企業は市の独自の支援により高度な技術に磨きをかける。「テクニカルブランド」はモノづくりリーディング企業の称号でもある。

インターネプコンジャパンで、さいたま市はテクニカルブランド企業6社とともに市の高度技術の集積を発信する。

日本省力技術研究所

日本省力技術研究所の液体定量吐出装置は、オリジナル構造のマイクロギアポンプ（MGP）を使用し、温度、粘度による吐出量の変化がほとんどない。このため、微少量吐出でも長時間安定した反復吐出が可能で、従来困難であった粘性液供給の自動化、省力化に貢献。展示会では高精度微少量吐出用2液混合吐出装置「ID－200N」を展示。同製品はMGPと速硬化樹脂対応のカートリッジ式ミキサーで構成。基礎データをもとに吐出量、混合比などを数値で設定管理でき、ウレタン、エキシポ、シリコン樹脂などの吐出を長時間安定的に行う。微少量吐出が要求される電機・電子部品や自動車部品、電池などの接着シール工程に適している。

このほか、ウレタン、エキシポ樹脂など多量吐出用「ID－300N」、廉価版「MGP－X020」などを出展。

FUJI
innovative spirit

ネプコン ジャパン2014 内
第43回 インターネプコン ジャパン
エレクトロニクス製造・実装技術展
会期：2014年1月15日[水]～17日[金]
会場：東京ビッグサイト
弊社ブースNo. 東7-46

待望の次世代プラットフォームが
今、ここに・・・。

New!
モジュール型高速多機能装着機
NXT III
Fuji Scalable Placement Platform

FUJIの先端技術を集積した「NXTIII」が、次世代実装技術のサポート、さらなる高効率生産を実現します。

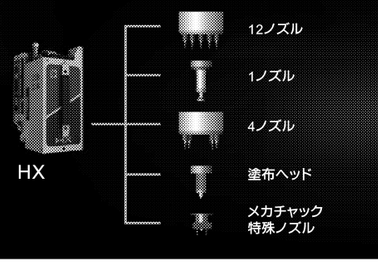
・新開発の装着ヘッドにより03015サイズを含むチップ部品において生産能力35,000cphを実現
・高剛性フレーム、新画像処理システムの開発により搭載精度±25μmを実現
・操作性が向上し、誰でも直感的な操作が可能

New!
拡張型オールインワン装着機
AIMEX IIs
AIMEXのコンセプトを継承し、試作から量産まで、小型高密度基板から500mmを超える大型基板まで対応できるオールインワン装着機です。

小型高性能スクリーン印刷機
NXTP-M35
デュアルレーン生産に対応したコンパクト印刷機。

モジュール型自動組立機
SmartFAB
人的作業を必要とする大型・異形部品挿入工程の自動化により、省人化に大きく貢献します。

New!
革新的な装着ヘッドシステム
ダイナヘッド（HX）
※開発中 AIMEX IIs対応
12ノズル/4ノズル/1ノズルの各ツールを自動交換しながら生産できる凡用ヘッド。超小型部品の高速装着から大型異形部品の装着まで高効率な実装が可能です。



超高密度大気圧プラズマユニット
Tough Plasma
樹脂接着強度の向上、濡れ性向上など、洗浄工程に大きく貢献します。

Integrated IT Solutions
IPQC
SMTラインにおける変化事象と検査結果を常時監視・分析。不良の発生前に効果の高い対策を案内します。

Floor Insight
生産現場の稼働状況を遠隔地からでもリアルタイムでモニタリング可能。各種レポートから、ボトルネックを分析・改善実行を支援します。

省人化ツール
現場作業・メンテナンス作業のスキルレス化を実現。トレーニングを必要とせず、だれでも素早く正確な作業を実現します。

●オートスプライシング ●オートリールローダ ●オートヘッドクリーナー

富士機械製造株式会社 ハイテック事業本部
本社／工場　〒472-8686　愛知県知立市山町茶碓山19
TEL：(0566)81-2111(代表)　FAX：(0566) 81-8238
東京支店　TEL：(03)5460-0241(代表)　FAX：(03) 5460-0250
大阪支店　TEL：(06)6385-7904(代表)　FAX：(06) 6368-1061
http://www.fuji.co.jp